

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成25年4月11日(2013.4.11)

【公開番号】特開2010-186752(P2010-186752A)

【公開日】平成22年8月26日(2010.8.26)

【年通号数】公開・登録公報2010-034

【出願番号】特願2010-97358(P2010-97358)

【国際特許分類】

H 01 R 11/01 (2006.01)

H 01 B 5/16 (2006.01)

C 09 J 7/00 (2006.01)

C 09 J 9/02 (2006.01)

C 09 J 201/00 (2006.01)

C 09 J 11/00 (2006.01)

【F I】

H 01 R 11/01 5 0 1 C

H 01 B 5/16

C 09 J 7/00

C 09 J 9/02

C 09 J 201/00

C 09 J 11/00

【手続補正書】

【提出日】平成25年2月27日(2013.2.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

<第2の回路部材>

前記第2の回路部材は、前記第1の回路部材の配線材と対向する面に配線材又は電極が形成されたものであり、例えば配線材を有するフレキシブル基板、ICチップなどが挙げられる。

前記第2の回路部材の配線材又は電極としては、例えば、NiSnメッキが施されたCu、NiAuメッキが施されたCuなどが挙げられる。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0030】

前記第1の回路部材の配線材としては、例えばアルミニウム、クロム、チタン、銅、モリブデン等の金属；ITO、IZO等の金属酸化物(透明電極材料)などが挙げられ、1種又は2種以上の金属、金属酸化物(透明電極材料)を積層させてもよい。

前記絶縁膜としては、例えばSiNx、その他有機系絶縁膜などが挙げられる。

前記第2の回路部材の配線材又は電極としては、例えば、NiSnメッキが施されたCu、NiAuメッキが施されたCuなどが挙げられる。